

中信建投证券股份有限公司

关于

**东方晶源微电子科技（北京）股份
有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市**

之

上市保荐书

保荐人



二〇二六年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、施亚骏已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况.....	5
二、发行人本次发行情况.....	19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式.....	20
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....	24
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.....	24
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.....	25
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程.....	26
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明.....	27
九、持续督导期间的工作安排.....	31
十、保荐人关于本项目的推荐结论.....	32

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、东方晶源	指	东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司
北京集电	指	北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）
应用材料	指	Applied Materials, Inc.
日立高新	指	Hitachi High-Technologies Corporation
阿斯麦/ASML	指	ASML Holding N.V，总部位于荷兰的全球最大的半导体设备制造商之一
睿初科技/ASML-Brion	指	Brion Technologies，2007 年与 ASML 公司实现战略合并，成为 ASML 旗下重要的战略子公司
新思科技/Synopsys	指	Synopsys, Inc.或其有关实体
西门子 EDA/Siemens EDA	指	Siemens AG 旗下 Siemens EDA 部门或其有关实体，原明导资讯（Mentor Graphics Corporation）
汉民微测/阿斯麦-汉民微测/ASML-HMI	指	Hermes Microvision, Inc.汉民微测科技股份有限公司，2016 年被阿斯麦 ASML 收购
02 专项	指	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的 16 个国家科技重大专项中的第 2 项，即“极大规模集成电路制造装备与成套工艺”
报告期、最近三年	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年度
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
本次发行及上市	指	东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市
《公司章程》	指	在本上市保荐书中，根据上下文意所需，指当时有效的《东方晶源微电子科技（北京）有限公司章程》《东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	自发行人本次发行及上市完成之日起生效的《东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司章程（草案）》
《审计报告》	指	立信为本次发行及上市出具的标准无保留意见的信会师报字[2026]第 ZB11342 号《审计报告》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

上交所	指	上海证券交易所
元	指	除特别说明外，人民币元
EDA	指	Electronic Design Automation，电子设计自动化，利用计算机辅助设计软件，来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线）及后续制造（版图设计、设计规则检查等）等流程的设计方式
CD-SEM	指	Critical Dimension Scanning Electron Microscope，电子束关键尺寸量测设备
EBI	指	Electron Beam Inspection，电子束缺陷检测设备
DR-SEM	指	Defect Review Scanning Electron Microscope，电子束缺陷复检设备
HV-SEM	指	High Voltage Scanning Electron Microscope，高能电子束设备
HPO	指	Holistic Process Optimization，芯片设计制造全流程优化方案
良率	指	也称成品率（Yield），是完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值
DTCO	指	Design Technology Co-Optimization，设计与制造协同优化

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称:	东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司
英文名称:	Dongfang Jingyuan Electron Co., Ltd.
注册资本:	36,401.6097 万元人民币
法定代表人:	俞宗强
成立日期:	2014 年 2 月 18 日
整体变更为股份有限公司日期:	2023 年 5 月 23 日
住所:	北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 12 号楼
邮政编码:	100176
电话:	010-80823878
互联网网址:	www.dfjy-jx.com
电子信箱:	ir@dfjy-jx.com
信息披露和投资者关系负责部门:	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人:	王兆强
信息披露和投资者关系负责人联系方式:	010-80823878

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人的主营业务

东方晶源主营业务是集成电路量检测设备的研发、生产与销售以及集成电路制造类 EDA 软件的研发与销售，致力于解决芯片制造中的良率痛点问题，利用量检测设备硬件产品、制造类 EDA 软件产品以及不同产品的有机结合，为客户提供芯片制造良率提升的整体解决方案。

经过多年持续自主研发，公司现已成功推出多款自研的软、硬件产品，形成了多元化的芯片制造良率提升工具布局。集成电路量检测设备产品包括 CD-SEM（电子束关键尺寸量测设备）、EBI（电子束缺陷检测设备）、DR-SEM（电子束缺陷复检设备）和 HV-SEM（高能电子束设备）四款用于集成电路前道工艺的电子束量检测设备；制造类 EDA 软件产品主要是计算光刻软件等通过优化改进

光刻工艺以提高晶圆制造良率的集成电路制造类 EDA 软件。

集成电路量检测设备是集成电路前道工艺的核心装备,对于前道工艺的工艺研发、工艺调试和质量控制发挥着关键作用,帮助客户提升工艺水平,提高芯片良率,提升市场竞争力。随着集成电路制造向更先进节点不断演进,工艺复杂度呈指数级上升,工序数量显著增加,对晶圆制造厂良率管理与工艺控制能力提出了更高的要求,使得集成电路量检测设备的重要性不断提升。根据 Yole 统计,集成电路量检测设备价值量占集成电路前道设备的比例约 13%,仅次于刻蚀及清洗设备、薄膜沉积设备和光刻机。集成电路量检测设备主要分为光学与电子束两大技术路线,两者互相补充,共同占据了行业绝大多数的市场份额。电子束量检测设备是集成电路前道设备中技术难度最高、国产化率最低的设备品类之一,市场被应用材料、日立高新、阿斯麦-汉民微测等国际龙头企业占据。公司通过持续的研发创新,掌握了关键核心技术,实现了对于电子束量检测设备的技术突破。公司已构建起涵盖 CD-SEM、EBI、DR-SEM 及 HV-SEM 四大品类的电子束量检测设备产品矩阵,实现了在电子束量检测设备核心品类上的全面布局,打破了国际龙头的垄断。公司最新型号的 CD-SEM 和 DR-SEM 已取得批量订单,验证结果显示公司产品的技术指标与国际厂商主流设备相当。公司产品在客户端准入阶段完成了多维度严格技术验证与长时间压力测试,充分验证了自身产品的技术成熟度与产线适配能力。公司的 EBI 设备系境内首款成功研发并通过产业化验证的电子束缺陷检测设备,进入产线量产已超过 5 年,产品性能持续迭代,不断取得新客户订单。公司 HV-SEM 已实现出机,正在进行产业化验证。

集成电路制造类 EDA 软件主要服务于晶圆制造环节的工艺研发、光刻优化及良率管理,是保障芯片良率的关键工具。计算光刻软件是制造类 EDA 软件中最重要的品类之一,主要用于光刻优化,包括研发光刻工艺、提升光刻分辨率以及扩大光刻工艺窗口。芯片制程越先进,特征尺寸越小,将会面对越发复杂的光学邻近效应、光刻胶曝光显影过程中的物理化学过程以及刻蚀效应的影响,想要实现良好的成像质量,就越需要计算光刻软件的支持。计算光刻软件是现代光刻工艺的核心软件,连接了芯片设计与制造两大环节,是 90nm 及以下制程集成电路制造的必备软件,能够提高光刻成像质量和晶圆制造良率,是技术含量最高、国产化率最低、对产线影响最深远的 EDA 软件品类之一,市场主要被西门子

EDA、新思科技和睿初科技三家国际龙头企业占据。公司计算光刻软件 PanGen 技术水平国内领先，可提供全套计算光刻解决方案，已在国内知名的逻辑芯片及存储芯片产线实现量产应用，性能达到国际先进水准，打破了国际厂商对计算光刻软件的垄断。不同于其他同类软件，PanGen 软件建立在 CPU+GPU 混合超算架构之上，并在多个产品模块引入人工智能技术，具有前瞻性和领先优势。同时，PanGen 也是全球最早实现全芯片反向光刻的计算光刻工具之一。

公司自成立以来，始终专注于集成电路制造的良率管理，以实现良率的可检测、可预测、可控制、可追溯和最优化，降低芯片制造门槛为愿景，在集成电路行业设计与制造协同优化（DTCO）构想的基础上，结合国内集成电路行业具体情况和公司实践，创造性地提出了以“电子束量检测和计算光刻”为核心技术的芯片设计制造全流程优化方案（HPO）。HPO 方案的核心内涵是打通设计和制造之间的双向数据交流，一方面将设计数据引入制造过程监控，利用设计数据更好地进行量检测定位和缺陷分析，实现智能量检测；另一方面利用制造过程数据实时向设计反馈，实现设计的及时修正和更新，加速芯片产品的设计迭代。通过更系统的优化提高芯片制造良率，帮助客户应对供应链及技术封锁、高端人才匮乏与产业生态滞后等多重挑战，降低芯片制造门槛和制造成本，为我国集成电路产业发展贡献力量。在电子束量检测设备和计算光刻软件两类产品的基础上，公司已经形成良率数据集成分析管理平台 YieldBook、设计可制造性检查软件 DMC、图形化工艺坏点仿真检测软件 PHD、刻蚀坏点仿真检测软件 vPWQ 等多款 HPO 软件产品，部分已实现产业化应用。未来，公司将进一步进行相关领域的研发，为客户提供更具竞争力的芯片设计制造全流程优化方案。

经过持续的研发创新和技术积累，公司的产品能力和市场影响力不断提升，逐步实现了与境外厂商的直接竞争。凭借国内领先的技术实力和应用经验，公司产品及服务得到了客户的认可。公司集成电路量检测设备和制造类 EDA 软件客户涵盖了逻辑芯片、存储芯片、第三代半导体、模拟芯片、功率芯片等多种芯片类型的制造厂商。

公司行业地位突出，先后承担 1 项国家科技重大专项（02 专项）、2 项国家科技重大专项（02 专项）课题/子课题、4 项国家发改委科技攻关项目、1 项工信

部工业强基项目等十余项国家/地方科研项目，是我国集成电路发展的重要力量，对全产业链安全具有重要的战略价值和意义。公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业和国家级高新技术企业，拥有北京经济技术开发区博士后工作站、北京市企业技术中心、新区企业研发机构等政府认定的高水平研发中心。公司曾荣获北京市首台（套）重大技术装备（CD-SEM、EBI 和 PanGen）、半导体投资联盟产业链突破奖（DR-SEM）、2022 年“科创中国”先导技术（装备制造领域）、第七届“IC 创新奖”-成果产业化奖、第五届“IC 创新奖”-技术创新奖、年度知识产权创新奖、北京市独角兽企业和北京民营企业科技创新百强等荣誉。

2、发行人的核心技术

东方晶源是从事集成电路量检测设备的研发、生产与销售以及集成电路制造类 EDA 软件的研发与销售的高新技术企业。成立之初，公司创始团队便创造性地提出了以“电子束量检测和计算光刻”为核心技术的 HPO 方案。经过多年持续的自主研发投入，公司在电子束量检测设备和计算光刻软件两大领域均取得了突破，并形成了深厚的技术和产品基础，公司主要产品均已产业化应用并形成规模化销售。

（1）集成电路量检测设备

公司在集成电路量检测设备领域的核心技术主要体现在设备整体设计方案及软件控制系统、电子光学系统和量检测核心算法三个方面，并通过系统层面的统一调试与整合，最终实现整机的性能指标，包括灵敏度、吞吐量、一致性和功能性等。其中，设备整体设计方案及软件控制系统指对运动及控制模组、电子光学系统与软件控制系统的整体设计与有机结合，是设备实现所有高性能指标的基础。电子光学系统是电子束量检测设备的核心系统，是设备实现高灵敏度、高一致性、高吞吐量、丰富功能的关键，是设备满足先进节点和复杂工艺要求的硬件基础。量检测核心算法是设备实现快速运行和丰富功能的关键，影响了设备的性能指标、可拓展性和易用性。

（2）集成电路制造类 EDA 软件

计算光刻软件通常至少包括光刻模型建模、光学邻近效应修正、设计规则检

查、光刻规则检查等主要功能或工具。除此以外，是否同时具备光源掩模联合优化、双重曝光/多重曝光、GPU 加速计算以及人工智能应用等先进功能模块也是决定计算光刻软件技术水平及支持先进工艺制程能力的关键因素。

公司的计算光刻软件产品 PanGen 是以光刻工艺建模为基础，以光学邻近效应修正和光源掩模联合优化两大光刻优化功能为核心，同时包含多重图形拆分、设计规则检查、光刻规则检查等多种功能的整套软件。公司计算光刻软件具备完整的功能模块，同时掌握先进节点技术，可以提供全套的解决方案，且各项技术能力均为国内领先，部分核心技术达到国际先进水平。

3、发行人的研发水平

公司始终以建设 HPO 平台为愿景，经过多年持续的自主研发投入，在集成电路量检测设备和集成电路制造类 EDA 软件领域积累了多项核心技术，并将科研成果及核心技术转化为专利进行保护与应用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 201 项授权发明专利（包括 148 项境内发明专利，53 项境外发明专利）、60 项授权实用新型专利、11 项授权外观设计专利。

公司围绕集成电路的设计和研发业务打造自身的核心竞争力。为保障公司的持续创新能力，公司构建了多层次的产品研发体系、完善的人才培养机制，并高度重视核心员工的激励和研发资源的投入，为公司未来发展提供了充足的人才、技术储备。

（1）致力于创新的产品研发体系

公司制定了全方位、系统化的科研管理与技术创新机制，从项目管理、科技成果转化、科研经费管理、知识产权管理、创新奖励等方面强化企业科技发展，促进技术创新。

在产品研发上，公司确立了合法合规、分级分类、产研结合、规范有序的原则；对科研项目组织架构及职责、管理内容等方面做出了明确规定。在成果转化方面，公司明确管理机构与职责，重视科技成果验收、科技成果转化等工作的推进。

(2) 完善人才培养体系

公司基于自身战略目标和业务发展规划，明确了人才培养的长期和短期目标，识别出关键岗位和人才缺口，有针对性地挖掘和培养人才。公司制定了全方位的人才培养计划，根据人才的不同价值，实施新人培训、专业技能培训、管理培训和能力提升项目等。公司建立了多元化的学习发展路径，提供多样化的职业发展通道，如技术专家序列、管理序列和项目管理序列等，满足不同员工的职业规划和发展需求。公司鼓励员工跨部门、跨领域学习，以拓宽视野，提升综合素质。公司建立了科学合理的绩效评估体系，定期评估员工工作表现和发展进度，并及时给予员工反馈。公司营造了积极向上的企业文化，强调学习，鼓励创新。

(3) 建立有效的激励机制

公司制定和实施了一系列创新的激励模式，主要包括股权激励、经营成果激励、科研项目激励、知识产权奖励等，建立以绩效考核为基础，岗位价值和创新成果相挂钩、短期激励和中长期激励相结合的激励机制。通过公平合理的奖励制度和畅通的职业晋升渠道，鼓励研发技术人员积极开展新产品、新工艺、新技术的科研攻关，支持研发技术人员申请承担公司重点专项、技改等科研项目。公司大力表彰及奖励做出突出贡献的优秀科研骨干人才。

(三) 发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产	129,440.05	126,802.75	141,446.92
非流动资产	25,938.62	27,854.18	17,411.40
资产合计	155,378.67	154,656.93	158,858.32
流动负债	63,449.09	41,751.93	49,169.71
非流动负债	63,219.43	38,184.04	20,675.93
负债合计	126,668.52	79,935.96	69,845.64
归属于母公司所有者权益	28,710.15	74,680.34	85,427.56

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	31,666.07	37,533.23	19,125.86
营业利润	-47,793.17	-14,954.07	-23,838.57
利润总额	-47,776.04	-14,999.85	-23,889.86
净利润	-47,776.35	-14,999.85	-23,889.86
归属于母公司所有者的净利润	-47,799.05	-13,757.36	-23,855.65
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-62,193.99	-35,484.35	-29,601.68

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	-24,693.83	-38,015.49	-25,335.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,262.57	6,947.56	-547.25
筹资活动产生的现金流量净额	27,759.65	1,171.22	19,851.69
现金及现金等价物净增加额	-234.85	-29,919.08	-6,031.56

4、主要财务指标

主要财务指标	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
流动比率（倍）	2.04	3.04	2.88
速动比率（倍）	1.25	1.82	2.12
资产负债率（合并）	81.52%	51.69%	43.97%
资产负债率（母公司）	75.07%	49.22%	42.29%
利息保障倍数（倍）	-34.99	-15.20	-27.85
应收账款周转率（次）	1.73	3.43	2.85
存货周转率（次）	0.30	0.42	0.22
息税折旧摊销前利润（万元）	-42,409.56	-9,192.10	-18,772.73
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	-47,799.05	-13,757.36	-23,855.65

主要财务指标	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-62,193.99	-35,484.35	-29,601.68
研发投入占营业收入的比例	94.89%	86.77%	133.19%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.68	-1.04	-0.70
每股净现金流量(元/股)	-0.01	-0.82	-0.17
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	0.79	2.05	2.35

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债=(流动资产-存货) / 流动负债；
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产；
- 4、利息保障倍数=(净利润+所得税费用+利息支出) / 利息支出；
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额；
- 6、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额；
- 7、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末普通股数量；
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末普通股数量；
- 10、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东的净资产 / 期末普通股数量。

(四) 发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

(1) 销售、客户、经营业绩相关的风险

1) 研发投入持续增加导致持续亏损的风险

报告期内，公司营业收入分别为 19,125.86 万元、37,533.23 万元和 31,666.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-29,601.68 万元、-35,484.35 万元、-62,193.99 万元。

半导体企业研发难度高，涉及的技术领域广，需要长期的研发投入以实现技术突破，其技术先进性直接影响下游晶圆厂的产品竞争力和生产良率。因此，公司需要长时间保持对研发的大量投入。报告期内，公司研发费用分别为 25,473.27

万元、32,568.33 万元和 30,047.87 万元，持续研发投入对公司的经营业绩和实现盈利造成一定影响。

2) 业绩波动风险

报告期内，公司的营业收入分别为 19,125.86 万元、37,533.23 万元和 31,666.07 万元。2023 年度至 2024 年度，随着公司产品逐步获得市场认可，新增订单增多，公司营业收入增加。由于公司产品迭代影响以及战略资源优先保障核心客户，2025 年度收入出现下滑。

半导体行业受国际经济波动、下游市场需求变化等多方面影响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造企业往往加大资本性支出，大幅提升对半导体设备的需求；但在行业景气度下降过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影响。

除上述行业周期影响外，如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济下行、国家产业政策变化、国际贸易摩擦加剧、下游客户投资需求发生波动、公司不能有效拓展新客户或研发投入未能及时实现产业转化等情形，将使公司面临一定的经营压力，导致公司未来业绩存在一定的波动风险。

3) 旧型号机台升级置换的相关风险

2025 年下半年，公司新一代电子束量检测设备陆续完成出机，设备多项关键指标明显提升。公司基于客户潜在增量订单、市场竞争、旧型号机台运营维护成本等多方面考虑，对部分客户处的旧型号机台进行升级置换，涉及 12 吋 CD-SEM 和 DR-SEM 两款机型。为客户升级置换系公司着眼于长期发展的举措，有助于公司快速完成新一代产品的市场导入，提前锁定客户未来采购需求，提升公司在高端电子束量检测设备领域的市场占有率和品牌影响力，但在实施过程中及短期内可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定不利影响。

4) 公司产品验收周期较长的风险

公司各类产品技术难度大，需要在客户现场长期验证，其验收周期受产品和工艺本身的成熟程度、客户安装现场的准备情况、客户工艺要求调整、客户验收流程等多种因素影响。如果公司产品验收周期延长，公司的收入确认将有所延迟。

同时，公司存在设备验收不通过、收款时间延后、存货规模提升等风险，可能会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

5) 毛利率下降风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 67.50%、48.11%和 39.70%，报告期内公司综合毛利率有所下降。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司产品迭代不及市场需求，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、低毛利率产品收入占比提高等不利情形，不排除公司综合毛利率水平出现波动甚至下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

6) 客户相对集中风险

报告期内，公司主营业务收入中前五大客户的金额分别为 11,308.01 万元、21,883.19 万元和 15,392.86 万元，占主营业务收入的比例分别为 59.33%、58.46%和 48.78%。虽然报告期内占比有所下降，但客户集中度仍然较高。目前，公司正积极进行市场拓展，客户结构日趋多元，但未来如果公司主要客户的生产经营或财务状况发生重大不利变化进而减少对公司产品的需求，或公司未能持续拓展新客户，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

7) 应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 4,924.79 万元、16,988.80 万元和 19,695.21 万元，占各期营业收入的比例分别为 25.75%、45.26%和 62.20%。随着公司经营规模、营业收入逐年增加，2024 年末，公司应收账款账面余额大幅增加，如果未来宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而增加坏账损失的风险。

8) 政府补助变动风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 5,017.41 万元、8,550.26 万元和 13,255.78 万元，主要系收到的科研项目奖励和相关政府部门补贴。如果未来公司承接的科研项目减少，或相关政府部门对公司所处行业的政策支持力度

减弱，或其他产业政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额可能有所降低，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。

（2）生产、存货相关的风险

1) 部分零部件供应商依赖的风险

目前，公司设备中使用的部分关键零部件主要由个别国外供应商供应，国内供应商仍处于技术研发追赶阶段。如果该等国外供应商因贸易政策、自身经营情况等因素停止为公司供货，将对公司的生产计划产生不利影响；若公司更换该等关键零部件的采购来源，可能会在过渡阶段出现供应中断，导致公司产品延迟交货，并产生高额费用，进而可能对公司的经营业绩产生不利影响；若公司未来在关键零部件价格上涨的过程中不能将压力转移到下游或不能通过技术工艺创新有效地控制成本，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

2) 存货余额较大及跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 37,025.87 万元、50,779.56 万元和 50,035.33 万元，占流动资产的比例分别为 26.18%、40.05%及 38.66%，存货账面价值占流动资产的比例较大，各期末存货跌价计提比例为 3.88%、7.84%和 31.91%。公司主要根据预计客户需求、公司库存情况等制定采购和生产计划，并根据市场变化动态调整备货水平。在业务规模不断扩大的情况下，公司通常会加大备货，使得存货余额随着业务规模的不断扩大而增加。如果客户的生产经营发生重大不利变化、客户产线建设放缓或延后，将导致公司存货余额较大并可能出现减值的风险。

（3）研发与技术相关风险

1) 公司在技术水平、产业化程度等方面与国际领先企业仍存在差距

国际领先的集成电路设备厂商进入市场多年，通过长期积累，在技术、市场和产品研发方面拥有先发优势，并确定了行业标准。公司在部分技术指标、产品线构成、产品迭代情况、应用领域、产业化程度、销售规模等方面与国际领先企业仍存在一定差距。若公司无法弥补与国际龙头企业之间的技术差距，或无法实现产品的规模化量产，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

2) 新产品研发及技术迭代风险

公司持续进行新产品研发和技术迭代。公司所处的集成电路行业为典型的技术和资金密集型行业，公司需要持续加大研发投入以推动公司产品升级换代。如果公司的技术研发方向不能顺应市场需求，或公司在关键技术、关键产品的研发进展落后于行业内竞争对手，亦或公司研发出的新产品不能满足客户要求，公司将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险，进而对公司经营业绩造成一定不利影响。

如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度减缓，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，集成电路量检测设备、集成电路制造类EDA软件行业存在技术壁垒高、研发难度大、验证周期长、资金投入多的特点，如果公司在研发过程中出现某些关键技术未能及时突破，或者研发成果未能及时实现产业化，或产品无法满足市场需要，将导致公司面临研发失败的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

3) 核心技术泄密风险

经过十余年来持续的技术积累，公司储备了一系列拥有自主知识产权的核心技术。为保障经营过程中所积累专有技术的保密性与安全性，公司通过严格执行研发全过程的规范化管理等相关措施避免技术失密。此外，公司还与主要技术人员签订了保密协议及竞业禁止协议，防范核心技术的外泄。

然而，上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况。一旦核心技术泄露，将可能给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

4) 存在知识产权被侵权的风险

公司坚持自主创新的研发战略，经过多年的技术开发和业务积累，拥有多项核心技术。公司建立了完善的知识产权维护机制以保护公司的知识产权免受侵犯。但是考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生，从而导致公司制止侵权行为产生额外费用，对公司正常业务经营造成不利影响。同时，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，以开发自有、底层技术为

主要研发路线，以避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展的风险。

（4）其他经营和管理风险

1) 资产负债率高的相关风险

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 43.97%、51.69%和 81.52%，呈现快速上升趋势。较高的资产负债率使公司面临一定的财务压力，若未来收入增长不及预期、下游客户回款周期延长或宏观货币政策收紧导致银行信贷额度收缩，公司可能面临流动资金周转紧张的局面，对公司正常生产经营造成不利影响。

报告期内，公司长期借款规模持续增长，财务费用支出不断提升，对公司净利润形成一定侵蚀。若未来市场利率上行、公司负债规模进一步扩大，财务费用将持续增加，直接压缩公司的盈利空间。此外，高资产负债率显著降低了公司的财务弹性，使得公司应对宏观经济下行、行业周期波动、突发政策调整或市场竞争加剧等外部不利冲击的能力下降。一旦出现核心客户流失、原材料价格大幅上涨等不利情形，可能对公司的持续经营能力与抗风险能力造成不利影响。

2) 公司持续亏损导致净资产为负的风险

截至报告期期末，公司归属于母公司所有者权益为 28,710.15 万元。公司经营收益、股东资本性投入等都会影响发行人净资产。由于公司目前尚未盈利且持续亏损，若公司无法持续获得股东资本性投入，则公司面临净资产为负的风险。

3) 募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募集资金投资项目主要为高端半导体良率管理设备研发升级及产业化项目、计算光刻和设计工艺协同优化 EDA 工具研发升级项目，募投项目的实施将对公司的发展战略和业绩水平产生重大影响。公司在本次发行前已对募投项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，但该研究主要基于当前产业政策、市场环境和技术水平等因素作出。若在项目实施过程中技术研发成果、投资成本等客观条件发生较大不利变化，则募投项目是否能够按时实施、研发产品是否能够成功上市并实现产业化、项目经济效益是否能够符合预期将存在不确定性。如果未来募投项目实施后，公司经营业绩不达预期或市场环境发生重大不利变化，公司销

售订单和营业收入不能在预期时间内随之增加，公司将面临募投项目无法达到预期收益的风险。

4) 募投项目用地尚未取得的风险

公司本次募投项目中高端半导体良率管理设备研发升级及产业化项目拟建设地址位于北京市北京经济技术开发区。截至本上市保荐书出具之日，公司尚未取得本次募投项目用地的土地使用权，虽然公司已经与北京经济技术开发区管理委员会签订了《国有建设用地使用权“先租后让、达产出让”合同》，但仍存在募投项目用地无法获取的风险。若公司未能取得该项用地的土地使用权或未能如期取得，可能对募投项目的实施产生不利影响。

2、与行业相关的风险

(1) 下游行业及下游客户资本性支出波动风险

公司所处的集成电路设备行业会因下游的半导体市场以及终端消费市场需求的变动而呈现一定程度的周期波动。近年来，半导体的市场需求持续增长，特别是中国半导体产业呈现高速增长的态势。因此，下游半导体制造企业在资本性支出方面也呈现出快速上升的势头。

如果未来下游半导体的终端需求有所减弱，行业景气度下降，导致下游客户削减资本性支出、扩产需求降低，将会减少集成电路设备行业的市场需求，从而对公司的持续发展产生不利影响。

(2) 市场竞争加剧风险

公司业务所处领域整体有较高的技术壁垒，需要长时间的技术积累。而中国大陆企业在该领域起步相对较晚，目前市场竞争格局仍主要由境外公司所主导。公司相较于海外领先竞争对手，虽在研发能力等方面具备一定竞争实力，但在技术积累、整体规模、营销网络、客户资源、融资渠道等诸多方面仍存在差距。随着中国大陆半导体产业整体能力的进步，公司也会面临本土同领域公司在细分产品市场的竞争。

在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋

势，不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，竞争决策失误、市场拓展不力，则公司的市场地位与经营业绩等可能受到不利影响。

(3) 吸引人才与保持创新能力的风险

发行人属于典型的知识密集型企业，对于研发、生产和管理等多维度人才依赖程度较高。一方面，为了适应日新月异的产业革新及满足下游客户的需求，企业研发人员需要具备微电子、计算机、物理学及材料科学等复合知识背景且拥有快速响应能力；另一方面，在产业化过程中，公司不仅需要根据行业内变化作出前瞻性判断，还需要与下游客户晶圆厂各合作伙伴保持良好的合作关系，这对于管理、产业人才也提出了更高的要求。

目前国内半导体行业发展迅速，企业间对上述人才的竞争十分激烈。如果公司无法建立有效的人才激励体系，或者人力资源管理不能适应快速发展的需要，将面临核心人才流失的风险，同时也可能陷入难以持续吸引优秀人才加盟的困境，从而导致公司无法保持持续的研发创新能力。

二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	不超过12,133.8800万股	占发行后总股本比例	不低于25%
其中：发行新股数量	不超过12,133.8800万股	占发行后总股本比例	不低于25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过48,535.4897万股		
每股发行价格	人民币【】元/股		
发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）	发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份

			总数计算)
发行后每股净资产	【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算)	发行后每股收益	【】元(以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算)
发行市净率	【】倍(按发行后每股净资产计算)		
发行方式	采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,或证监会或上交所批准的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)		
发行对象	本次发行对象为符合资格的询价对象和证监会、上交所认可的其他发行对象		
承销方式	余额包销方式		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	扣除新股发行费用后,募集资金净额【】万元		
募集资金投资项目	高端半导体良率管理设备研发升级及产业化项目		
	计算光刻和设计工艺协同优化 EDA 工具研发升级项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元,其中:(1)承销费及保荐费【】万元(2)审计费【】万元(3)律师费【】万元(4)其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	【】		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	本次发行不涉及股东公开发售,不涉及发行费用分摊,发行费用全部由发行人承担		
(二) 本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	【】年【】月【】日		

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他

成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定张林、施亚骏担任本次东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司首次公开发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

张林先生：保荐代表人，博士学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：七星电子 IPO、中国核电 IPO、筑博设计 IPO、复旦微电 IPO、中芯国际 IPO、燕东微 IPO、金凯生科 IPO、北方华创非公开发行、七星电子非公开发行、东方精工非公开发行、紫光股份非公开发行、铁汉生态非公开发行、中航动力发行股份购买资产并募集配套资金、七星电子发行股份购买资产并募集配套资金、紫光股份重大资产重组、燕东微向特定对象发行股票等，暂无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

施亚骏先生：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：煜邦电力 IPO，筑博设计可转债、渝农商行 IPO 审计等，暂无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行上市项目协办人

本次证券发行项目的协办人为李梦莹，其保荐业务执行情况如下：

李梦莹女士：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：金凯生科 IPO、煜邦电力 IPO、筑博设计 IPO、硅数股份 IPO、北方华创非公开发行、紫光股份非公开发行、中航沈飞重组上市、紫光股份重大资产重组、北方华创收购芯源微控股权、创智科技定向增发、创智科技重新上市等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行

上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行上市项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括曹东明、罗天翼、刘佳畅、梁晨杰、张帅、李书春、霍亮亮、陈望、史翌、甄逸恒。

曹东明先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：金凯生科 IPO、筑博设计 IPO、硅数股份 IPO、北方华创非公开发行、亦庄控股协议收购麦克奥迪等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

罗天翼先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：联芸科技 IPO 等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘佳畅先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：硅数股份 IPO、北方华创股权激励、紫光股份重大资产重组等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

梁晨杰先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：硅数股份 IPO、北京城乡重大资产重组等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张帅先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：硅数股份 IPO。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李书春先生：中国注册会计师，本科学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：新光光电 IPO、锋尚文化 IPO、中亦科技 IPO、浩辰软件 IPO、强一股份 IPO、同有科技重大资产重组、

旋极信息重大资产重组、皇台酒业恢复上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

霍亮亮先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：浩辰软件 IPO、明冠新材 IPO、花园生物 2016 年及 2019 年非公开发行、科大讯飞向特定对象发行股票等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈望先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：中亦科技 IPO、泰凌微 IPO、科大讯飞向特定对象发行股票、得利斯非公开和铁近科技新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

史翌先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：伟思医疗 IPO、帝尔激光 IPO、花王转债、同享科技向特定对象发行股票、欧普泰北交所上市、宏海科技北交所上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

甄逸恒先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：恒坤新材 IPO、宏海科技北交所上市等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
邮编：	100101
联系电话：	010-56051430
传真：	010-56160130

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

(一) 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况；

截至本上市保荐书签署日，保荐人中信建投系发行人股东中信建投投资的母公司，中信建投投资持有发行人 0.2880% 股份。

截至本上市保荐书签署日，保荐人中信建投的子公司中信建投投资持有发行人股东北京集电 5% 的合伙份额，存在关联关系，北京集电持有发行人 2.1843% 股份。

除上述情况外，截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况；

保荐人将根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规的规定安排相关方参与本次发行战略配售。

(二) 发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

(三) 保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况；

(四) 保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人的实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

(五) 保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其实际

控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人于 2025 年 11 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》等相关议案。发行人于 2026 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会决议有效期的议案》《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会授权有效期的议案》等相关议案。

发行人于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》等相关议案。发行人于 2026 年 6 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会决议有效期的议案》《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会授权有效期的议案》等相关议案。

经核查，本保荐人认为发行人已就本次发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

保荐人查阅了发行人所属行业的相关产业政策、行业研究报告、同行业公司的公开资料，了解行业技术发展情况、同行业公司的技术方向、国家战略方向、市场竞争情况；获取了发行人报告期内产品销售情况，分析比例变动趋势；获取了发行人核心技术人员的简历，了解其科研能力；获取了发行人报告期内研发投入明细、研发项目文件等，核查了研发投入情况；查阅了发行人已取得的发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等技术成果以及核心技术列表，了解发行人技术先进性、业务方向和技术水平。

经核查，本保荐人认为，发行人所从事的业务及所处行业符合国家战略，属于面向世界科技前沿、面向国家重大需求的科技创新行业。同时，发行人具备关

键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营，具有较强的科技创新能力，市场认可度较高，符合相关法律法规对科创板定位的要求。

经核查，本保荐人认为，发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》的规定，具体情况如下：

科创属性相关指标一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 99.73%，最近三年累计研发投入金额为 88,089.47 万元
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员占员工总数的比例为 49.45%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 182 项，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年营业收入复合增长率为 28.67%，2025 年度营业收入为 31,666.07 万元
科创属性相关指标二	是否符合	指标情况
发行人拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
发行人作为主要参与单位或者发行人的核心技术人员作为主要参与人员，获得国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于公司主营业务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
发行人独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司牵头承担并完成了 1 项国家科技重大专项（02 专项），独立承担并正在执行 2 项国家科技重大专项（02 专项）课题/子课题，独立承担并完成 1 项国家发改委科技攻关项目，独立承担并正在执行 3 项国家发改委科技攻关项目
发行人依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 182 项，超过 50 项

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、发行人的设立时间及组织机构运行情况

本保荐人查阅了发行人的工商档案、有关主管部门出具的证明文件、纳税资料等。经核查，确认发行人成立于 2014 年 2 月，于 2023 年 5 月整体变更为股份有限公司，自依法设立以来持续经营并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人财务规范情况

本保荐人查阅了立信会计师出具的《审计报告》等相关财务资料，并取得了财务相关的内外部文件。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3、发行人内部控制情况

本保荐人查阅了立信会计师出具的内部控制审计报告以及发行人内部控制制度等资料。经核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4、发行人资产完整性及业务、人员、财务、机构独立情况

本保荐人查阅了发行人的业务合同、三会文件、立信会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

5、业务、控制权及管理团队的稳定性

保荐人查阅了发行人三会文件及花名册、立信会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，最近二年内发行人主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；最近二年内发行人核心技术人员稳定且最近二年内没有发生重大不利变化；发行人实际控制人所持公司的股份权属清晰，最近二年发行人实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

6、对发行人持续经营有重大不利影响的事项

本保荐人查阅了发行人重要资产的权属证书、银行征信报告、立信会计师出具的《审计报告》等资料，并查询了中国裁判文书网等公开网站信息。经核查，发行人不存在影响持续经营的主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项，符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

7、发行人经营合法合规性

本保荐人查阅了立信会计师出具的《审计报告》、发行人相关业务合同，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

8、发行人、实际控制人的守法情况

本保荐人取得了发行人相关主管部门出具的合规证明及发行人实际控制人出具的承诺函，并查询了国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等网站。最近三年内，发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

9、董事、监事和高级管理人员的守法情况

本保荐人取得了发行人董事、监事和高级管理人员分别出具的调查表，并通过国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台进行查询。经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，发行人符合《首发注册管理办法》规定的上市条件。

(二) 符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

本次发行前，发行人的股本总额为 36,401.6097 万元，若本次公开发行的 12,133.8800 万股全部发行完毕，每股面值为人民币 1 元，发行后的股本总额将达到 48,535.4897 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

(三) 符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上”规定

本次发行前，公司已发行股份总数为 364,016,097 股，本次发行的股票数量不超过 121,338,800 股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的 25.00%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

(四) 符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定及《上市规则》第 2.1.2 条之“（二）预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”规定

根据《上市规则》2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研

发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”。

根据发行人最近一次外部股权融资对应的估值以及可比 A 股上市公司二级市场估值情况，发行人的预计市值不低于 15 亿元，满足所选择上市标准中的市值指标。发行人 2025 年度营业收入为 31,666.07 万元，最近三年累计研发投入为 88,089.47 万元，占最近三年累计营业收入 88,325.16 万元的 99.73%。发行人市值和财务指标符合《上市规则》第 2.1.2 条第二款之规定。

（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

发行人股票上市后，保荐人及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年。

持续督导事项	工作计划
1、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及发行人的报道，督导发行人履行信息披露义务
2、督导发行人有效执行并完善防止实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行
3、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程（草案）》的规定，协助发行人制定有关制度并督导其实施
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程（草案）》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人参会并提出意见和建议
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金投资项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程（草案）》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定

7、中国证监会、证券交易所及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、上交所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作
---------------------------	--

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 李梦莹

李梦莹

保荐代表人签名: 张林 施亚骏

张林

施亚骏

内核负责人签名: 徐子桐

徐子桐

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 刘成

刘成

